



THP-100 Series 熱硬化型穴埋めインキ

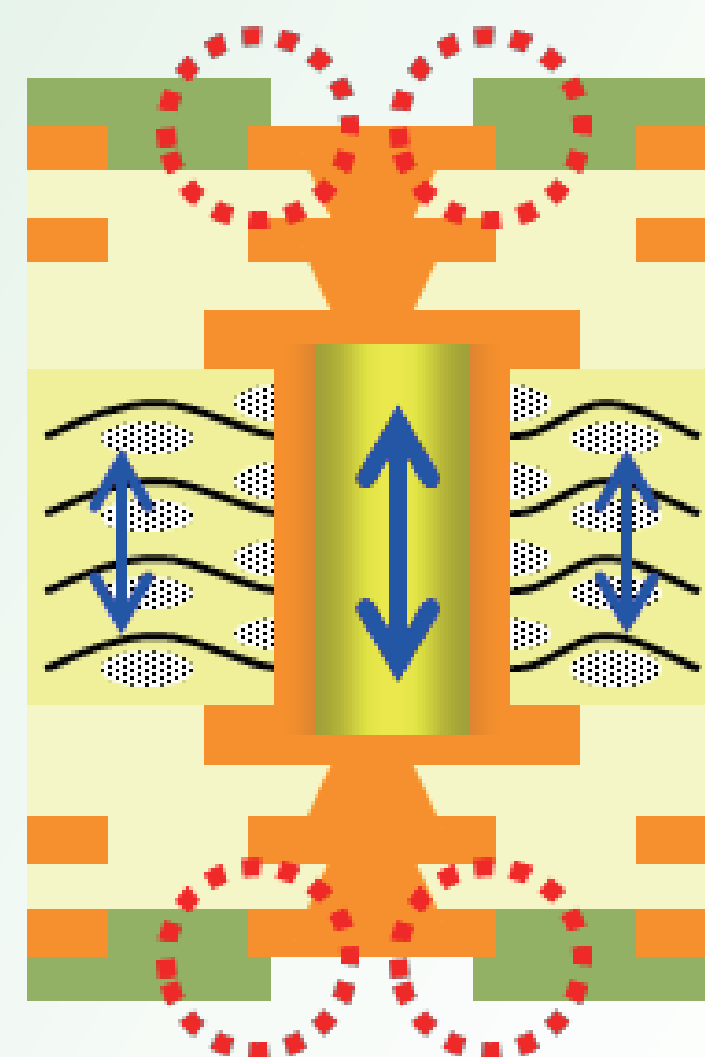
Thermal Curable Permanent Hole-Plugging Materials

特長 Features

THP-100 DX7

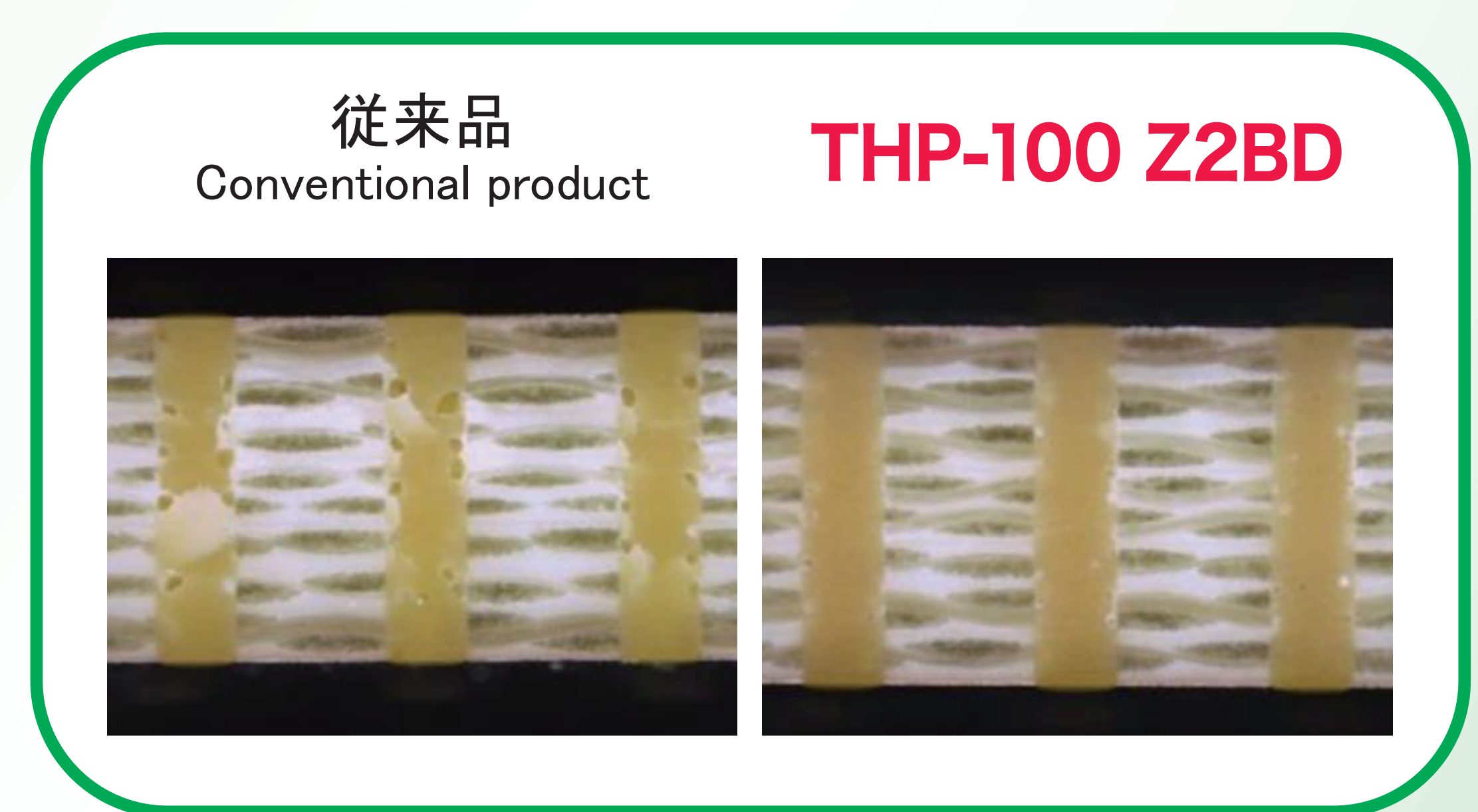
- 高Tg / 低CTE High Tg / Low CTE
- 高信頼性 High reliability
-65°C⇔150°C、1000Cycleクラックなし
リフロー耐性良好

	従来品 Conventional product	THP-100 DX7
Before Reflow		
L2a (C-120/60/60)+ Reflow (270°C/5cycles)		



THP-100 Z2BD

- バックドリル対応 For Back-drill type
- 保存安定性良好 Very long pot life
- アウトガスによるボイド低減
Excellent for void due to outgas



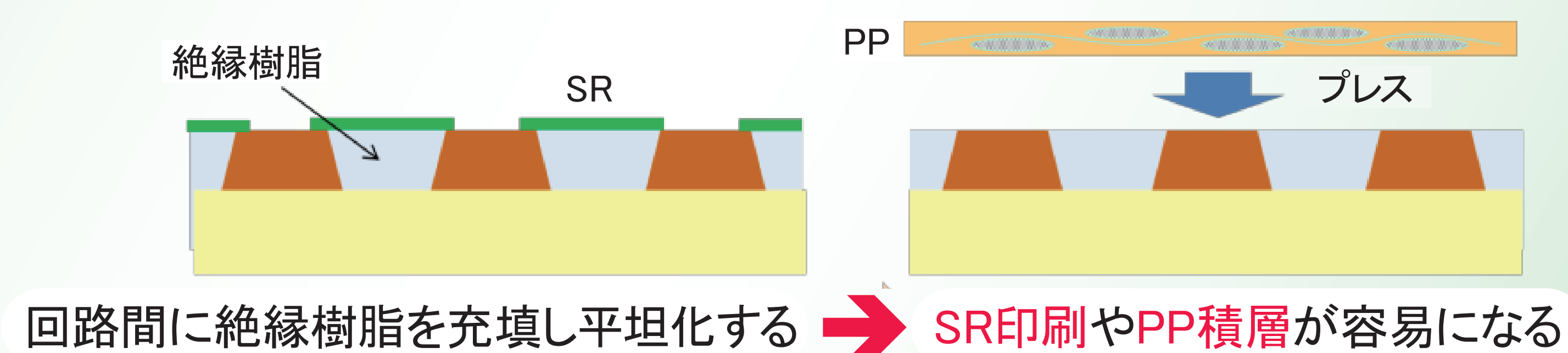
ギャップ埋めインキ

Thermal Curable Gap Filling Material

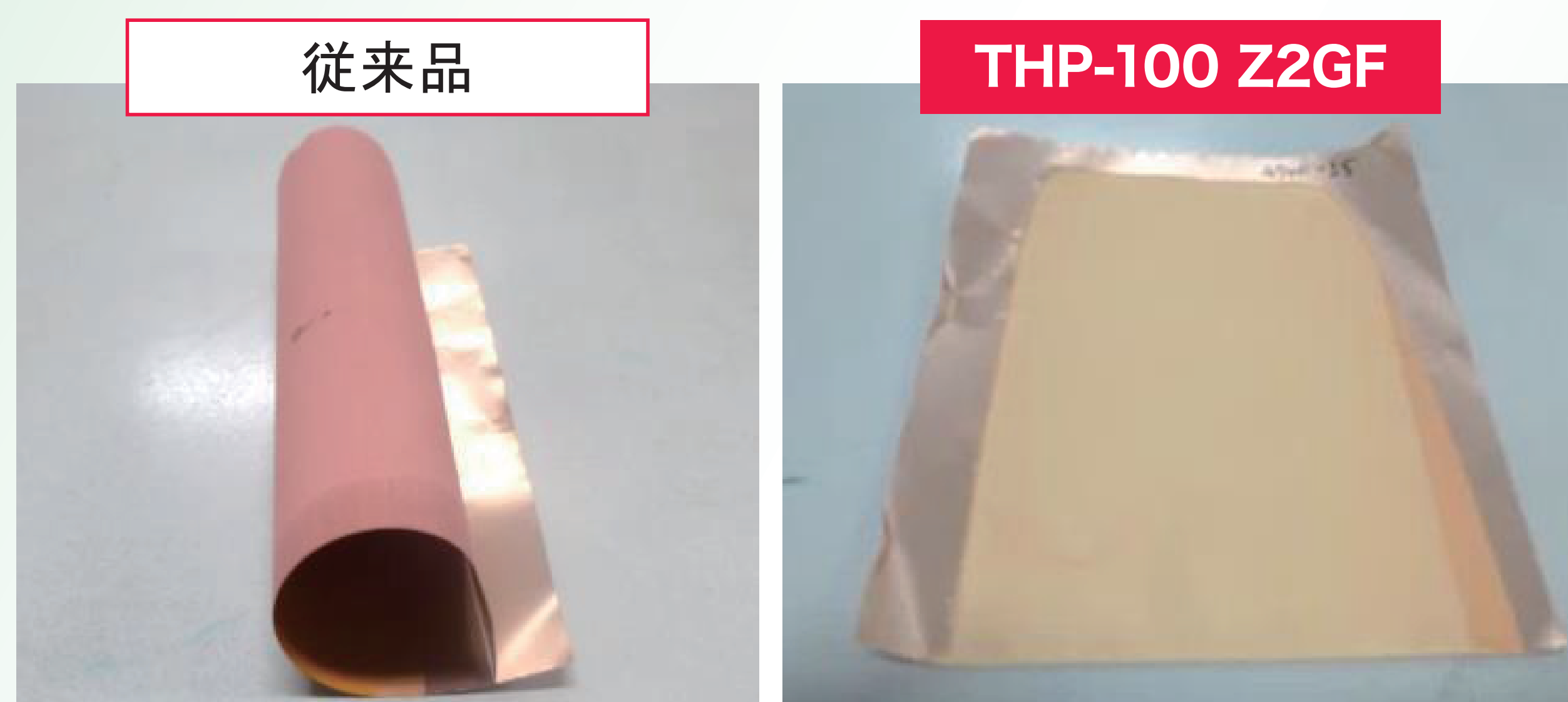
特長 Features

THP-100 Z2GF

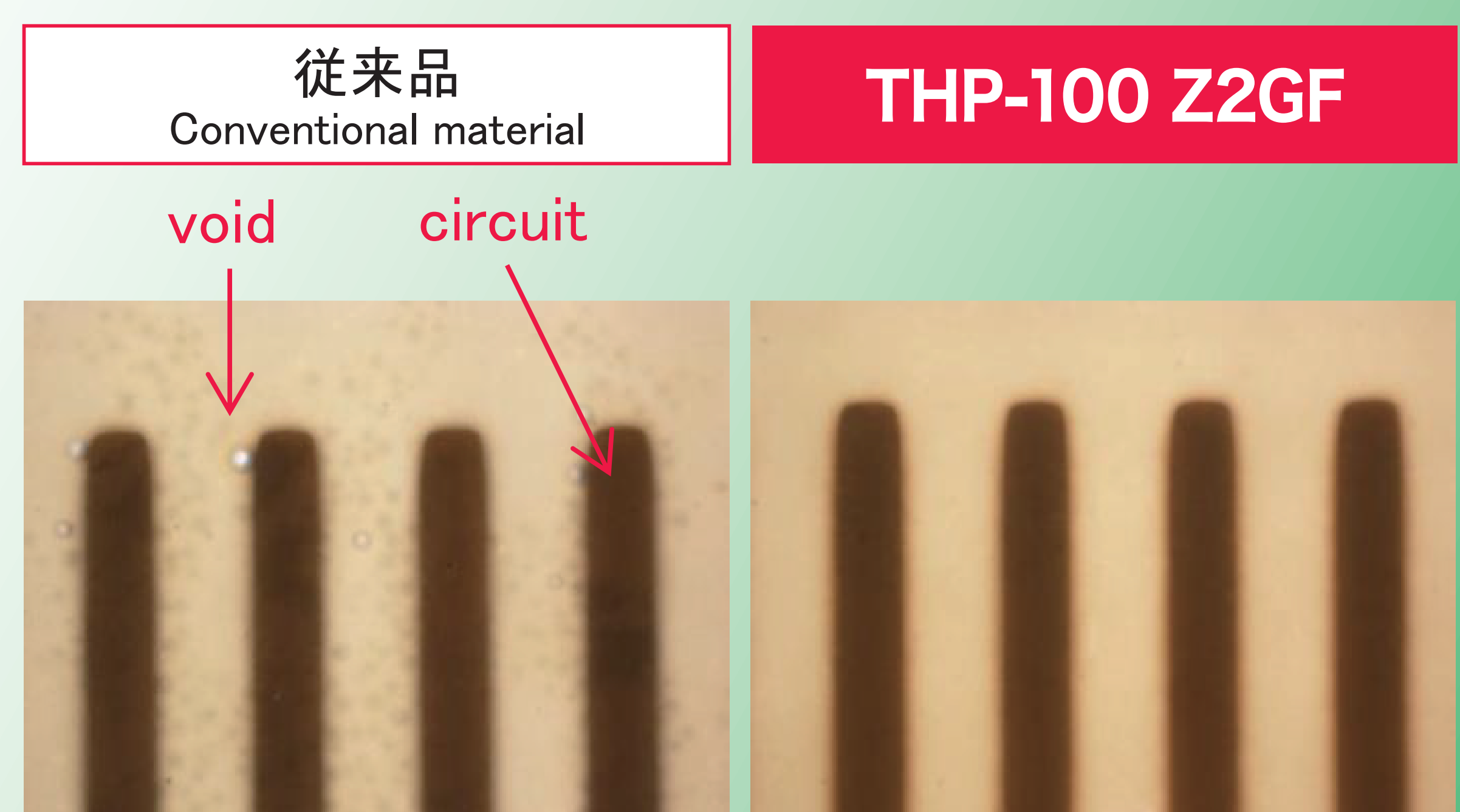
- 回路厚の厚い基板に対して回路間にギャップ埋めインキを充填して平坦化することができます
Gap filling material can be used to fill high copper circuits for planner layer.



- 低反り Low warpage



- 大気印刷においてもボイドフリー Void free



TAIYO INK MFG. CO., LTD.